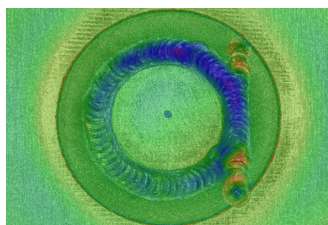
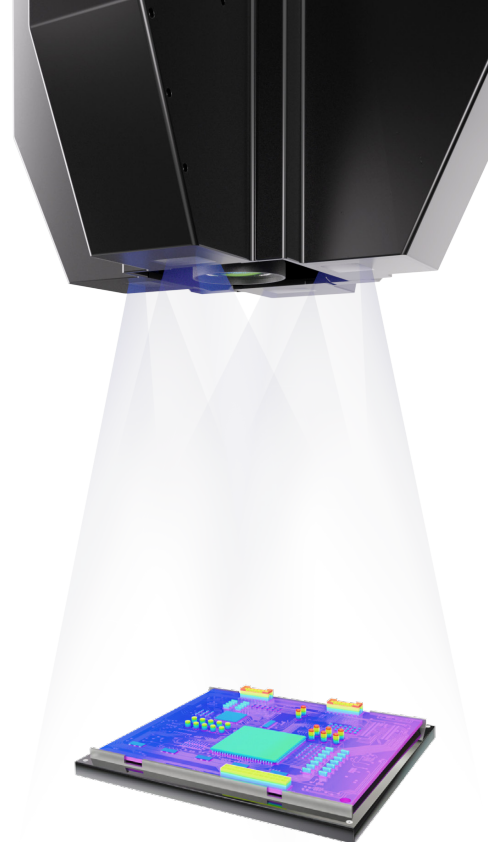
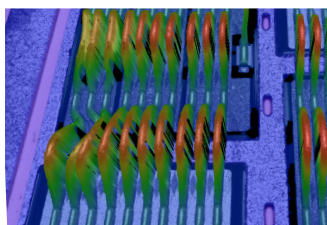


Sizector®3D相机SX系列

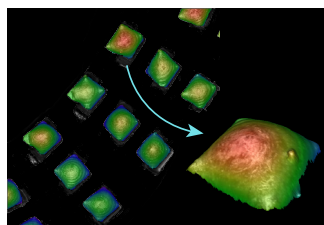
Sizector®3D相机SX系列同时搭载多投影和硬件计算成像技术,能够消除单一投影方向造成的图像阴影和盲区,同时解决了高反物体表面容易出现的单边飞点、孔洞等3D重构失真问题。应用于半导体、动力锂电、PCBA、连接器、新能源汽车等行业高难度的3D在线检测。



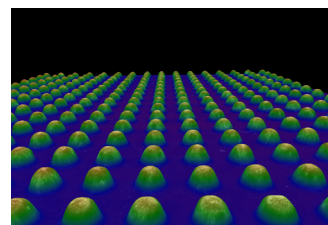
锂电池密封钉



IGBT引线



扁线电机焊点



BGA锡球

消除阴影和高反影响, 更高完整性的3D点云

采用多投影技术, 拍摄多组不同投影方向的3D点云进行硬件融合, 完整性更高

精度高、速度快

相机硬件端多3D融合后输出高精度3D点云, 相比PC-base系统数据传输量骤减, 不增加计算时间

像素级对齐的2D+3D数据, 实现一站式高精度融合测量

可实现2D和3D数据像素级对齐

搭配外部光源同步实现2D+3D一站式融合测量和检测

外接RGB光源获取无拜尔矩阵、3CCD成像效果的真彩3D点云



www.megaphase3d.com

多投影+远心镜头

产品参数	最大投影数 (个)	全周期帧率 (FPS)	数据分辨率 (px)	基准距离 (mm)	标准视场范围 (mm)	深度测量范围 (mm)	Z轴区域重复精度 ^{*1,2} (μm)	像素间距 (mm)	尺寸 (LxWxH,mm)	重量 (kg)
SS081017	1	≤ 5.4 $\leq 18.7(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	115	17.7x17.7	± 2	<0.1	0.006	202.5x88x285	<4.7
ST081017	2	≤ 3.0 $\leq 10.5(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	115	17.7x17.7	± 2	<0.1	0.006	305x88x285	<5.6
SQ081017(N)	4	≤ 1.4 $\leq 4.8(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	115	17.7x17.7	± 2	<0.1	0.006	305x305x285 299x299x230(N)	<7.1 4.9(N)
ST081032C	2	≤ 3.0 $\leq 10.5(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	120	32.8x32.7	± 5	<0.16	0.011	280x77x244	<3.9
ST081043	2	≤ 2.7 $\leq 9.6(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	105	43.4x43.3	± 4	<0.2	0.015	310x114.5x280	<6
SQ081043(N)	4	≤ 1.5 $\leq 5.3(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	105 100(N)	43.4x43.3	± 5	<0.2	0.015	300x300x280 319x319x233(N)	<7 5(N)
SQ081060N	4	≤ 1.5 $\leq 5.2(\text{Binning})$	810万 (2856x2848)	195	61.6x61.4	± 6	<0.5	0.021	327x327x280.5	7.9
ST162053	2	≤ 2.0 $\leq 7.3(\text{Binning})$	1620万 (5328x3040)	185	53x30.2	± 10	<0.3	0.010	330x130x335	<8.5
SQ162053(N)	4	≤ 1.0 $\leq 3.6(\text{Binning})$	1620万 (5328x3040)	185	53x30.2	± 10	<0.3	0.010	330x330x335 329x329x284.5(N)	<11 6.5(N)

多投影+FA镜头

产品参数	最大投影数 (个)	全周期帧率 (FPS)	数据分辨率 (px)	基准距离 (mm)	标准视场范围 (mm)	深度测量范围 (mm)	Z轴区域重复精度 ^{*1,2} (μm)	像素间距 (mm)	尺寸 (LxWxH,mm)	重量 (kg)
STF162090	2	≤ 2.0 $\leq 7.3(\text{Binning})$	1620万 (5328x3040)	130	90x51.4	± 15	0.05	0.017	340x166x57.5	3.4

通用工作参数

光源	蓝色LED
数据接口	USB3.0
符合标准	CE, GenICam
I/O输入输出	2路无极性电平信号输入 / 开关信号输出 (12/24V兼容)
工作电压/电流	24V / 5A
SDK操作系统	Linux / Windows 7、8、10、11
SDK支持的编程语言	C / C++ / C# / Python
工作温度	0~40°C
存储温度	0~60°C
工作湿度	20%~80% (无凝结)

*1 全视野、全景深重复精度: 分别在正极限景深、零平面、负极限景深拍摄目标物, 每个FOV均匀取9个边角区域进行测量, 取27个Z轴重复精度数值^{*2}的最差结果; 目标物为陶瓷板。

*2 Z轴区域重复精度: 区域A的Z均值到区域B的Z均值的差的100次测量一倍标准差。A、B面积为1%FOV, 两者相邻。

*以上产品外观及产品参数如有变更恕不另行通知, 请访问公司官网获得实时信息



盛相科技微信公众号

上海|深圳|成都|苏州|宁德
 电话: +86 199 2109 3166
 邮箱: Sales@mega-phase.cn
 网址: www.megaphase3d.com